



2 KEYS 電容式觸摸按鍵

產品描述

- 提供 2 個觸摸感應按鍵，一對一直接輸出，輸出為開漏(open drain)型態，適合作 AD 鍵。提供低功耗模式，可使用於電池應用的產品。對於防水和抗干擾方面有很優異的表現。

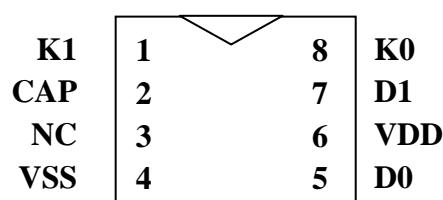
產品特色

- 工作電壓範圍：3.1V - 5.5V
- 工作電流： 3mA (正常模式)；15 uA (休眠模式) @5V
- 2 個觸摸感應按鍵
- 持續無按鍵 4 秒，進入休眠模式
- 提供一對一的直接輸出，輸出為開漏(open drain)型態，按鍵時輸出為低電平
- 可以經由調整 CAP 腳的外接電容，調整靈敏度，電容越大靈敏度越高
- 具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板，按鍵仍可有效判別
- 內建 LDO 增加電源的抗干擾能力

產品應用

- 各種大小家電、娛樂產品。

封裝腳位圖



8-SOP



腳位定義

腳位	腳位名稱	類型	功能描述
1	K1	I	觸摸按鍵腳，串接100-1000歐姆，能提高抗干擾和提高抗靜電能力
2	CAP	-	電容須使用 NPO 材質電容或 X7R 材質電容 使用範圍：6800pF-33000pF，電容越大靈敏度越高
3	NC	-	空接
4	VSS	P	電源負端
5	D0	O	K0 的狀態輸出，無按鍵時為高阻抗(OD)，有按鍵時為低電平
6	VDD	P	電源正端
7	D1	O	K1 的狀態輸出，無按鍵時為高阻抗(OD)，有按鍵時為低電平
8	K0	I	觸摸按鍵腳，串接100-1000歐姆，能提高抗干擾和提高抗靜電能力

接腳類型

- I COMS 輸入
- O COMS 輸出
- P 電源



AC/DC Characteristics

- Absolute maximum ratings

Item	Symbol	Rating	Unit
Operating Temperature	Top	-20°C ~ +70°C	°C
Storage Temperature	Tsto	-50°C ~ +125°C	°C
Supply Voltate	VDD	5.5	V
Voltage to input terminal	Vin	Vss – 0.3 to Vdd + 0.3	V

- D.C. Characteristics

(Condition : Ta= 25 ± 3 °C , RH ≤ 65 % , VDD =+ 5V , VSS=0V)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Operating voltage	VDD		3.1	5	5.5	V
Operating current	I _{OPR1}	VDD=5V	-	3	-	mA
Input low voltage for input and I/O port	V _{IL1}		0	-	0.3VDD	V
Input high voltage for input and I/O port	V _{IH1}		0.7VDD	-	VDD	V
Output port source current	I _{OH1}	V _{OH} =0.9VDD, @5V	-	4	-	mA
Output port sink current	I _{OL1}	V _{OL} =0.1VDD, @5V	-	8	-	mA

- A.C. Characteristics

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
System clock	f _{SYS1}	OSC @5v	-	4	-	MHz
Low Voltage Reset	V _{lvr}		2.0	2.2	2.4	V



輸出指示

- 提供 **2 keys** 電容觸摸按鍵，輸出是採用一對一直接輸出，未按鍵時輸出為開漏型態，按鍵時為低電平輸出。
- 功能描述：
 1. VK3702OM 於手指按壓觸摸盤，在 60ms 內輸出對應按鍵的狀態。
 2. 單鍵優先判斷輸出方式處理，如果 K1 已經承認了，需要等 K1 放開後，其他按鍵才能再被承認，同時間只有一個按鍵狀態會被輸出。
 3. 具有防呆措施，若是按鍵有效輸出連續超過 10 秒，就會做復位。
 4. 環境調適功能，可隨環境的溫濕度變化調整參考值，確保按鍵判斷工作正常。
 5. 可分辨水與手指的差異，對水漫與水珠覆蓋按鍵觸摸盤，仍可正確判斷按鍵動作。但水不可於按鍵觸摸盤上形成“水柱”，若如此則如同手按鍵一般，會有按鍵承認輸出。
 6. 內建 LDO 及抗電源雜訊的處理程序，對電源漣波的干擾有很好的耐受能力。
 7. K0~K1 中不使用的按鍵請接地，避免太過靈敏而產生誤動。
 8. D0~D1 中不使用的輸出請接地，避免浮接會有漏電流的情況。

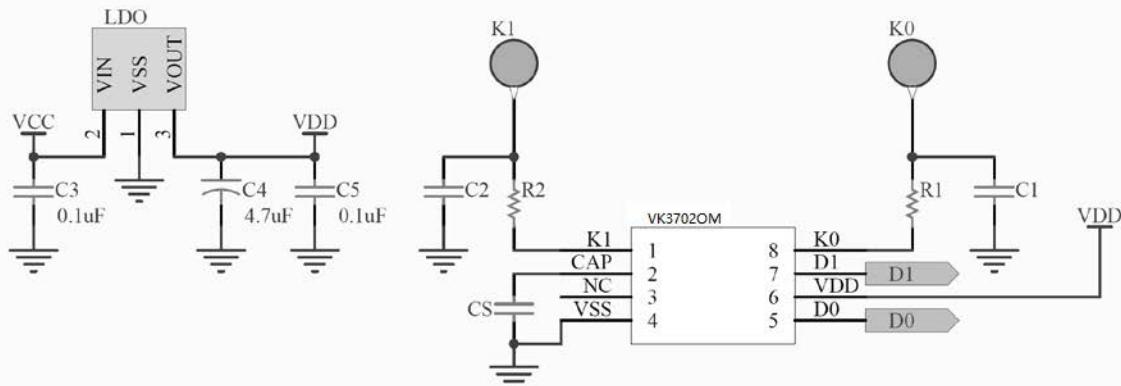


- 注意事項：

1. **C_s** 電容和靈敏度的關係：
 - ① **C_s** 電容越小，觸摸靈敏度越低
 - ② **C_s** 電容越大，觸摸靈敏度越高
 - ③ **C_s** 電容值範圍在 6800pF (682) — 33000pF(333)之間
 - ④ 由於 **C_s** 量測的電容，要選擇對溫度變化係數小，容值特性穩定的電容材質，所以須使用 **NPO** 材質電容或 **X7R** 材質電容。
2. 電源的佈線 (**Layout**) 方面，首先要以電路區塊劃分，觸摸 **IC** 能有獨立的走線到電源正端，若無法獨立的分支走線，則儘量先提供觸摸電路後在連接到其他電路。接地部分也相同，希望能有獨立的分支走線到電源的接地點，也就是採用星形接地，如此避免其他電路的干擾，會對觸摸電路穩定有很大的提升效果。
3. 單面板 **PCB** 設計，建議使用感應彈簧片作為觸摸盤，以帶盤的彈簧片最佳，觸摸盤夠大才能獲得最佳的靈敏度。
4. 若使用雙面 **PCB** 設計，觸摸盤 (**PAD**) 可設計為圓形或方形，一般建議 12mm x 12mm，與 **IC** 的連線應該儘量走在觸摸感應 **PAD** 的另外一面；同時連接線應該儘量細，也不要繞遠路。
5. **PCB** 和外殼一定要緊密的貼合，若鬆脫將造成電容介質改變，影響電容的量測，產生不穩定的現象，建議外殼與 **PAD** 之間可以採用非導電膠黏合，例如壓克力膠 3M HBM 系列。
6. 為提高靈敏度整體的雜散電容要越小越好，觸摸 **IC** 接腳與觸摸盤之間的走線區域，在正面與背面都不鋪地，但區域以外到 **PCB** 的周圍則希望有地線將觸摸的區域包圍起來，如同圍牆一般，將觸摸盤周圍的電容干擾隔絕，只接受觸摸盤上方的電容變化，地線與區域要距離 2mm 以上。觸摸盤 **PAD** 與 **PAD** 之間距離也要保持 2mm 以上，儘量避免不同 **PAD** 的平行引線距離過近，如此能降低觸摸感應 **PAD** 對地的寄生電容，有利於產品靈敏度的提高。
7. 電容式觸摸感應是將手指視為導體，當手指靠近觸摸盤時會增加對地的路徑使雜散電容增加，藉此偵測電容的變化，以判斷手指是否有觸摸。觸摸盤與手指所構成的電容變化與觸摸外殼的厚度成反比，與觸摸盤和手指覆蓋的面積成正比。
8. 外殼的材料也會影響靈敏度，不同材質的面板，其介電常數不同，如 玻璃 > 有機玻璃 (壓克力) > 塑膠，在相同的厚度下，介電常數越大則手指與觸摸盤間產生的電容越大，量測時待測電容的變化越大越容易承認按鍵，靈敏度就越高。



應用線路圖



PS: 1. C1、C2 = 1-5P，必要時調降靈敏度用，電容越大靈敏度越低。

2. R1、R2 = 1KΩ

3. CS = 682-333 電容越大靈敏度越高

- **Cs 外接電容與壓克力厚度關係：**

以鐵片彈簧鍵，圓型實心直徑 12 MM 為例，壓克力厚度與 CS 電容的關係如下：

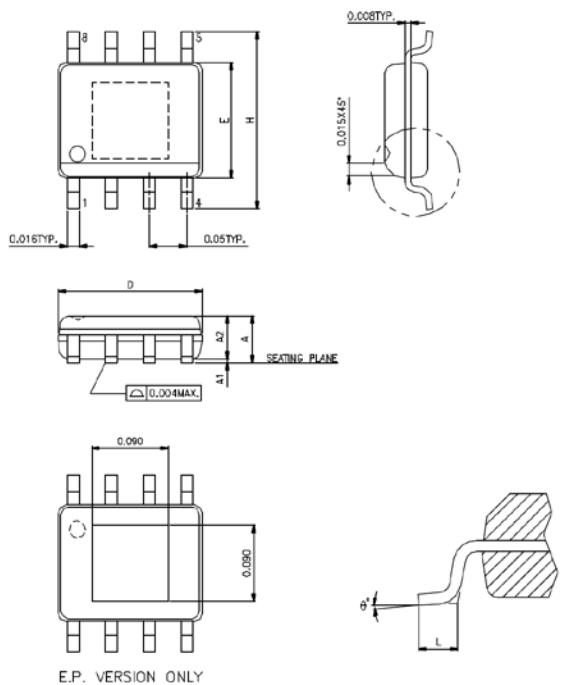
壓克力厚度 (mm)	CS	靈敏度設定
1	682	30
2	103	30
3	153	30
4	223	30
5	223	30
10	333	30

此表格僅供參考，不同的 PAD 大小，PCB layout 皆會影響。



封裝說明

- SOP 8



SYMBOLS	MIN.	MAX.
A	0.053	0.069
A1	0.004	0.010
A2	—	0.059
D	0.189	0.196
E	0.150	0.157
H	0.228	0.244
L	0.016	0.050
θ°	0	8

UNIT : INCH

NOTES:

- 1.JEDEC OUTLINE : MS-012 AA / E.P. VERSION : N/A
- 2.DIMENSIONS "D" DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH, PROTRUSIONS AND GATE BURRS SHALL NOT EXCEED .15mm (.006in) PER SIDE.
- 3.DIMENSIONS "E" DOES NOT INCLUDE INTER-LEAD FLASH, OR PROTRUSIONS. INTER-LEAD FLASH AND PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .25mm (.010in) PER SIDE.

訂 購 資 訊

VK3702OM

封裝型號

晶片型號

晶圓型號

SOP 8

—

—

- HTTP://WWW.SZVINKA.COM